

AREMCO CRYSTALBOND™

Description de la gamme CRYSTALBOND™ : Solutions d'assemblage temporaire (bâtons, films...)

La gamme CRYSTALBOND™ de AREMCO est idéale pour le montage et démontage facile de produits qui nécessitent une découpe, un polissage, ou d'autres procédés d'usinage.

Ces adhésifs adhèrent facilement aux métaux, aux verres et à la céramique.

Faciles à mettre en oeuvre, ils présentent une excellente résistance mécanique pour les étapes d'usinage.

Chaque produit est présenté avec un produit de nettoyage non inflammable. CRYSTALBOND 555™ peut se nettoyer à l'eau chaude.



Caractéristiques

Produit	Type	Point de fusion	Couleur	Applications
Crystalbond 509™ Nettoyant 509-S ou Acétone	Bâton	74 °C	Ambre Jaune Incolore	Excellente adhérence. Permet de réduire l'encrassement des Outils de découpe lié à l'utilisation d'autres types de cires. Peut être dissous puis déposé par spray. Se dissout dans 509-S nettoyant non inflammable.
Crystalbond 555™ Nettoyant 509-S ou eau chaude	Bâton	54 °C	Blanc	Adhésifs à faible point de fusion. Transparent en fines sections. Soluble dans l'eau chaude.
Crystalbond 555-HMP™ Nettoyant 509-S ou eau chaude	Bâton	66 °C	Blanc	Adhésifs à faible point de fusion. Transparent en fines sections. Soluble dans l'eau chaude.
Crystalbond 590™ Nettoyant 590-S ou alcool isopropylique	Bâton	150 °C	Marron	Haute résistance mécanique Pour la découpe de petites pièces et usinage entraînant un échauffement.
Wafer-Mount 559™ Acétone ou MEK	Feuille	NA	Transparent	Film plastique semi-rigide activable par pression couche adhésive soluble pour le démontage. Idéal pour le travail des wafers avec maintien par aspiration.
Wafer-Mount 562™ Nettoyant 562-S	Feuille	NA	Blanc	Film adhésif thermoplastique. Idéal Pour le travail d'échantillons fins et fragiles quand une épaisseur homogène est requise (planéité) Soluble dans 562-S nettoyant non-inflammable.

La liste ci-dessus n'est pas exhaustive, pour toute autre demande, n'hésitez pas à nous contacter

Fiche Produit

Applications

Découpe et polissage de composants optiques

Usinage de céramiques

Découpe de céramiques, semi-conducteurs, wafers

Découpe de ferrites, verres et piézoélectriques

Découpe de monocristaux Montage d'échantillon pour la microscopie électronique Renforcement arrière de composants pour un support mécanique temporaire Gravure sèche par plasma

Mentions légales



Biesterfeld France SARL

4 boulevard Bellerive

CS 10045

92566 Rueil-Malmaison Cedex

Contact : Alexandre Long – Sales Manager France

Tel. : +33 6 75 66 94 93

E-mail : a.long@biesterfeld.com

www.biesterfeld.com

Les informations techniques, textes et illustrations concernant les produits proviennent de nos fournisseurs.

Clause de non-responsabilité : Nous ne pourrions être tenus responsables de l'adéquation des produits avec l'utilisation prévue par le client sauf si l'obtention d'un résultat d'utilisation précis est expressément mentionnée dans le contrat. Les conseils, informations ou préconisations relatifs aux applications sont communiqués sur la base de nos connaissances actuelles. L'application faite du produit dépassant notre champ d'influence et les résultats d'une telle application n'étant pas totalement prévisibles, les indications écrites et verbales, suggestions, etc. ne peuvent être fournies que sur une base non contraignante. Les conseils, informations ou préconisations ne dégagent en particulier pas le client de l'obligation de vérifier l'adéquation des produits avec les processus et utilisations envisagés.

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018. Nous nous engageons à traiter vos données de contact de manière confidentielle et à garantir la sécurité des informations qui nous sont fournies. Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, veuillez adresser un court message à a.long@biesterfeld.com.

Vous pouvez consulter notre politique de confidentialité sur www.biesterfeld.com/en/xx/privacy-policy/.